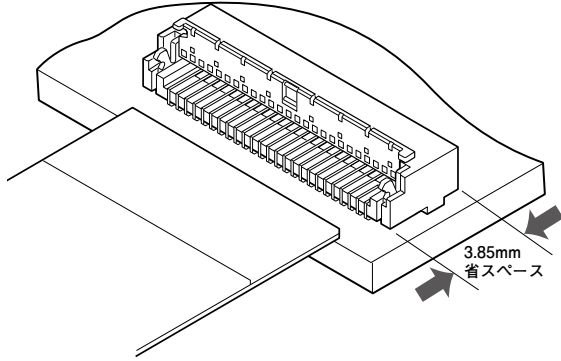


FXS CONNECTOR

0.3mmピッチ / プリント基板用 / FPC用・ZIFタイプ



嵌合方向の省スペース化を重点に置き、高さ 1.8mm / 奥行き 3.85mm を実現した、省スペースフリップロックタイプコネクタ。

- ・実装面積を大幅に縮小
- ・回転式カバー構造
- ・ロック構造の強化

■一般仕様

- ・定格電流：0.2A AC/DC
- ・定格電圧：50V AC/DC
- ・使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
- ・接触抵抗：初期 / 50mΩ以下
環境試験後 / 50mΩ以下（初期からの変化量）
- ・絶縁抵抗：50MΩ以上
- ・耐電圧：AC200V を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきこと
- ・適用 FPC：導体ピッチ / 0.3mm（0.6mm 千鳥配列）
導体幅 / 0.3mm
接触部厚さ / 0.2 ± 0.03mm

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料末項）に掲載のご使用上の注意事項を参照ください。

※RoHS2 対応品を掲載しています。

※寸法の単位には mm を採用しています。

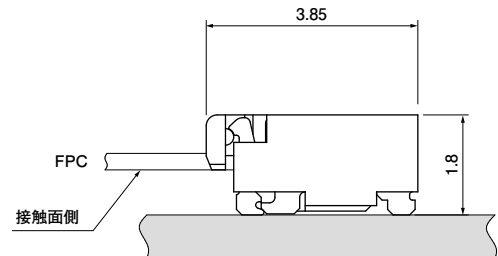
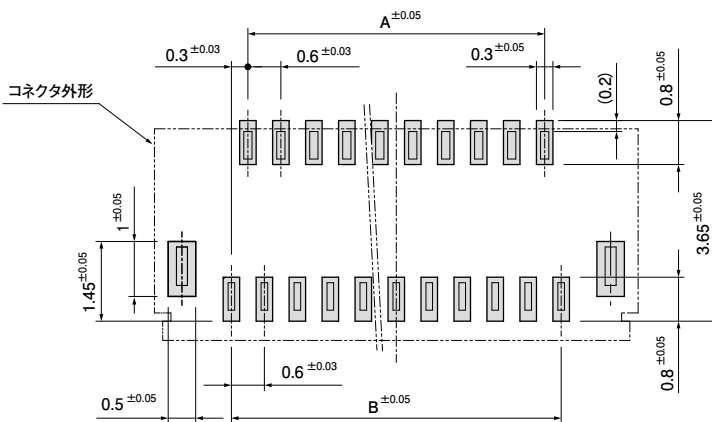
※詳細は弊社までお問い合わせください。

■登録規格

海外規格登録については、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料）に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。

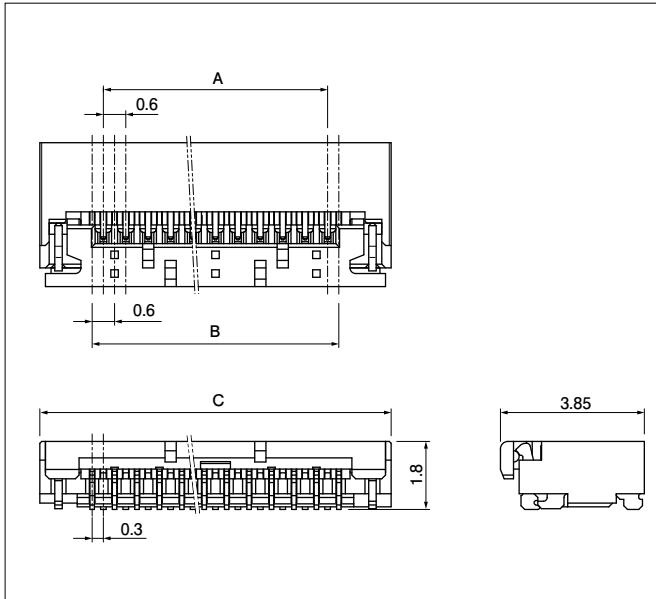
※海外規格に登録の仕様は、上記の一般仕様と異なる場合があります。

基板レイアウト・組立レイアウト



- 注 1) 基板レイアウトはコネクタ装着側から見た図です。
 2) 基板のパターンピッチの公差は±0.03で累積しないこと。
 上記記載の寸法は参考値ですので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

コネクタ



金めっき品

極数	形番	寸法 (mm)			個数/ リール
		A	B	C	
21	21FXS-RSM1-GAN-TF(B)	5.4	6.0	8.8	2,500
25	25FXS-RSM1-GAN-TF(B)	6.6	7.2	10.0	2,500
33	33FXS-RSM1-GAN-TF(B)	9.0	9.6	12.4	2,500
51	51FXS-RSM1-GAN-TF(B)	14.4	15.0	17.8	2,500

材 料・表面処理等

コンタクト：銅合金、ニッケル下地付部分金めっき
 ハウジング：耐熱性樹脂
 補強金具：銅合金、銅下地付すずめっき
 カバー：耐熱性樹脂

注) すずめっき品をご希望の場合はお問い合わせください。

FPC リード部寸法

